

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【公開番号】特開2012-146788(P2012-146788A)

【公開日】平成24年8月2日(2012.8.2)

【年通号数】公開・登録公報2012-030

【出願番号】特願2011-3331(P2011-3331)

【国際特許分類】

H 05 K 1/14 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/14 H

H 05 K 1/14 G

【手続補正書】

【提出日】平成25年8月23日(2013.8.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2面のうち少なくとも一方の面上に半導体素子が実装される第1の基板と、

2面のうち少なくとも一方の面上に半導体素子が実装され、前記第1の基板に対向する第2の基板と、

基端が前記第1の基板に固定され、先端側が前記第1の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第1の接続端子板と、

基端が前記第2の基板に固定され、先端側が前記第2の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第2の接続端子板と、

前記第1の接続端子板の平面部と前記第2の接続端子板の平面部の少なくとも一方に形成したねじ挿通部を通して、前記第1の接続端子板の平面部と前記第2の接続端子板の平面部とが当接する状態で前記第1の接続端子板と前記第2の接続端子板を締結するためのねじ部材と、

を備えたことを特徴とする基板間接続構造。

【請求項2】

前記第1の接続端子板と第2の接続端子板のうちの一方の接続端子板には前記ねじ部材が通るねじ挿通部が形成され、他方の接続端子板は前記ねじ部材が螺入するねじ孔を有し、

前記ねじ挿通部は、前記ねじ孔よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の基板間接続構造。

【請求項3】

前記第1の接続端子板と第2の接続端子板の少なくとも一方は、前記第1の基板と第2の基板が接近する方向に変形して公差を吸収する公差吸収部を有することを特徴とする請求項1または2に記載の基板間接続構造。

【請求項4】

前記公差吸収部は、接続端子板に切り欠きを形成することにより構成したことを特徴とする請求項3に記載の基板間接続構造。

【請求項5】

前記第1の接続端子板は、前記基端から、前記第2の基板に対し接離する方向に延びる

第1の部位と、第1の部位の先端から前記第1の基板に対向する方向に延び前記平面部を構成する第2の部位を有し、

前記第2の接続端子板は、前記基端から、前記第1の基板に対し接離する方向に延びる第1の部位と、第1の部位の先端から前記第2の基板に対向する方向に延び前記平面部を構成する第2の部位を有することを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の基板間接続構造。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

請求項1に記載の発明では、2面のうち少なくとも一方の面に半導体素子が実装される第1の基板と、2面のうち少なくとも一方の面に半導体素子が実装され、前記第1の基板に対向する第2の基板と、基端が前記第1の基板に固定され、先端側が前記第1の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第1の接続端子板と、基端が前記第2の基板に固定され、先端側が前記第2の基板から離間する方向に延びるとともに平面部を有する第2の接続端子板と、前記第1の接続端子板の平面部と前記第2の接続端子板の平面部を通じて、前記第1の接続端子板の平面部と前記第2の接続端子板の平面部とが当接する状態で前記第1の接続端子板と前記第2の接続端子板を締結するためのねじ部材と、を備えたことを要旨とする。